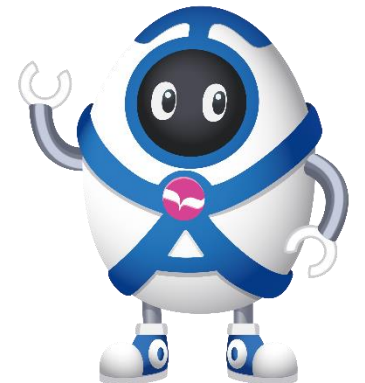


第47回定時株主総会 －事業説明会－

2025年6月27日



事業内容

新事業

- ・TSS
(トータルソリューションサービス)
- ・精密加工用工具、受託加工
- ・微細加工
- ・コーティング



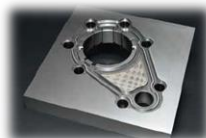
改造・修理
予防保全



微細加工技術



工具 (エンドミル)



受託加工

レーザー加工装置事業

- ・レーザトリマ
- ・ウェハーマーカ
- ・レーザ溶接機



レーザトリミング装置
Model SL432R



ウェハーマーキング装置
Model SL473GS3

半導体事業

- ・半導体製造用精密金型
- ・半導体製造用モールドイング装置
- ・半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファ金型



モールドイング装置
Model PMC2030-D



コンプレッション金型



モールドイング装置
Model CPM1080

メディカルデバイス事業

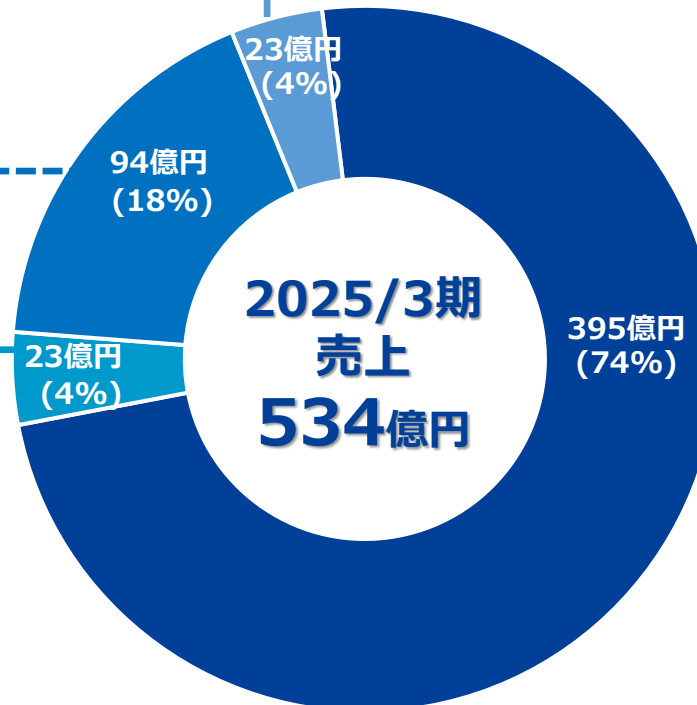
- ・ファインプラスチック成形品
- ・医療機器



点滴用部品



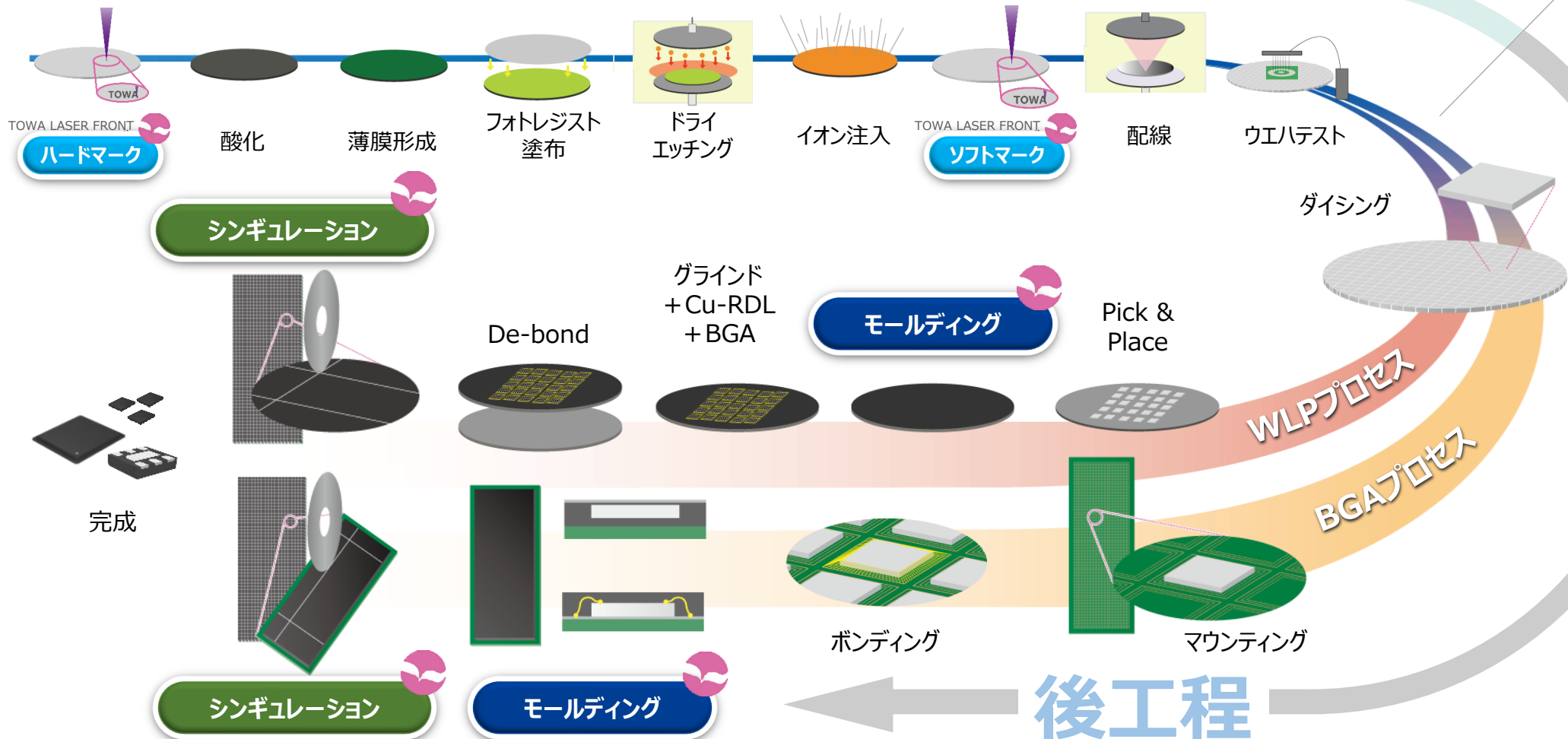
注射器用部品



半導体・TSS事業におけるTOWAのプロセスソリューション

豊富な経験と実績で最先端半導体プロセスに応える

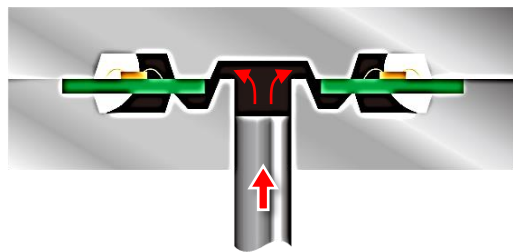
前工程



TOWAメイン事業

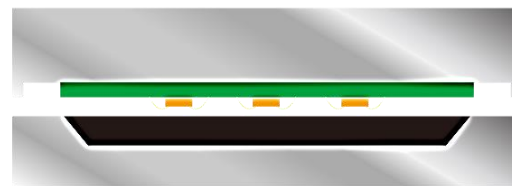
モルディング

注入



トランスファ成形

圧縮



コンプレッション成形

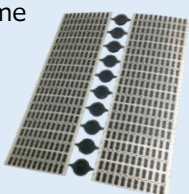
多様化するパッケージの要求に応え
革新的な成形機能を搭載

固形樹脂をポット入れ、溶融した樹脂をキャビティ（彫り込み）に押し流して充填させ硬化させる成形手法

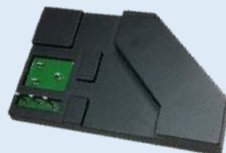
トップシェアを誇る独自の**圧縮成形**
HBMや最先端半導体の多くに採用！

顆粒または液状など樹脂をキャビティに直接入れ、溶融した後にワークを樹脂に浸けて硬化させる成形手法

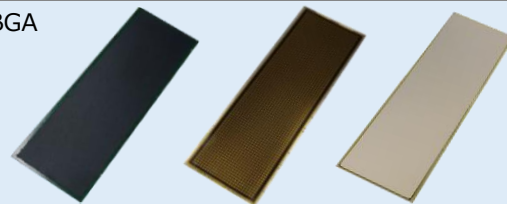
Lead Frame



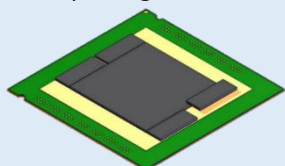
ECU



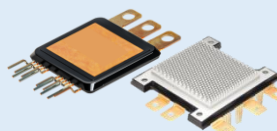
MAP BGA/QFN/HS BGA



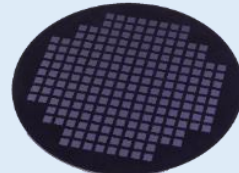
Exposed package and Module



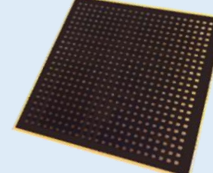
Power Module



WLP (Wafer Level package)

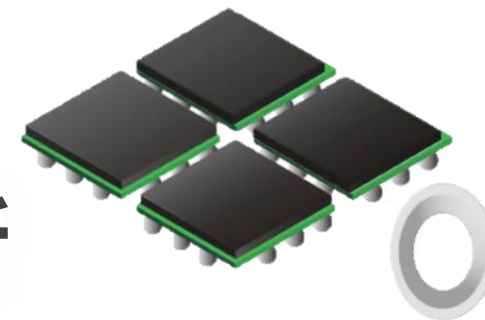


PLP (Panel Level package)



シングュレーション

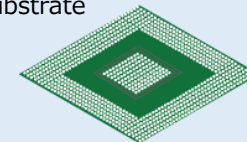
切断



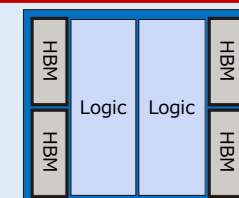
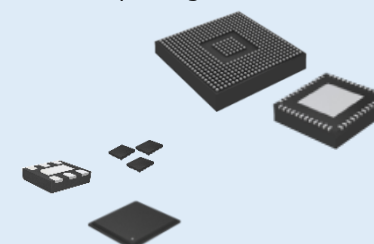
切るだけじゃない！**自動化・省人化**に
寄与する次世代シングュレーション

樹脂で封止された製品を回転するブレードにて切断し個片化・収納する工程

Substrate



Thicker package



TOWAが選ばれる理由

常に業界をリードし**新技術・新製品**を生み出し続けてきました

TOWAモルディング革命の歴史

1

1979 マルチプランジャ仕様の製品化
業界標準の確立



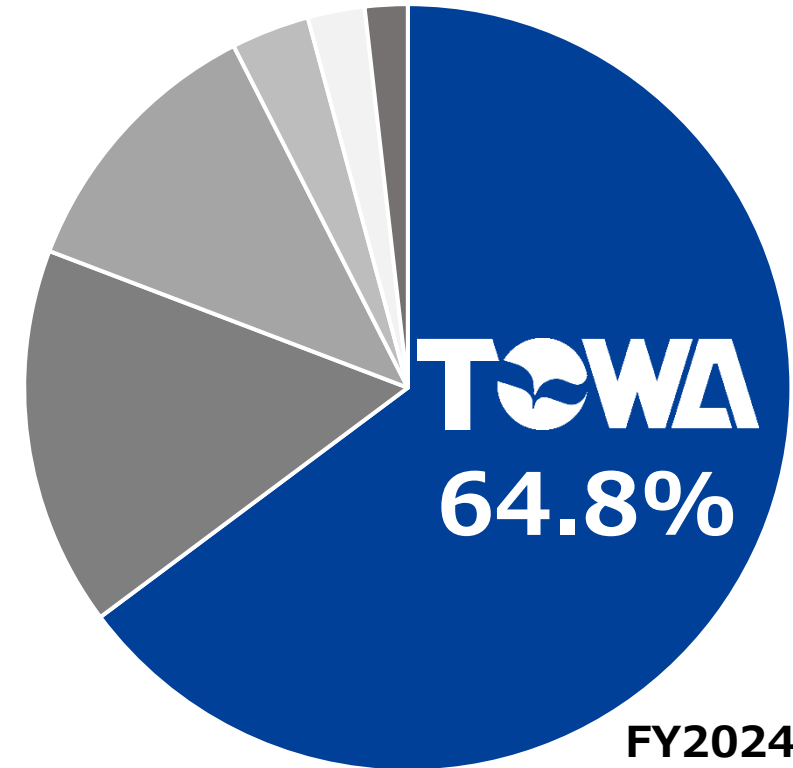
2

1995 モジュールシステムの製品化
Yシリーズ爆発的ヒット



3

2009 コンプレッション装置の市場投入
新たな業界標準の確立



半導体モルディング装置の**世界シェアNo.1**

半導体製造プロセスにおけるTOWAの役割と強み

開発拠点の近くで試作を支援するグローバルラボ体制

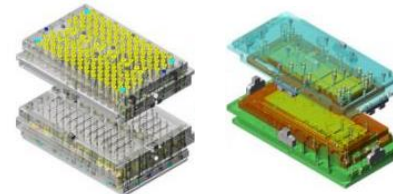


成形評価・検証



量産化提案

製品を市場へ



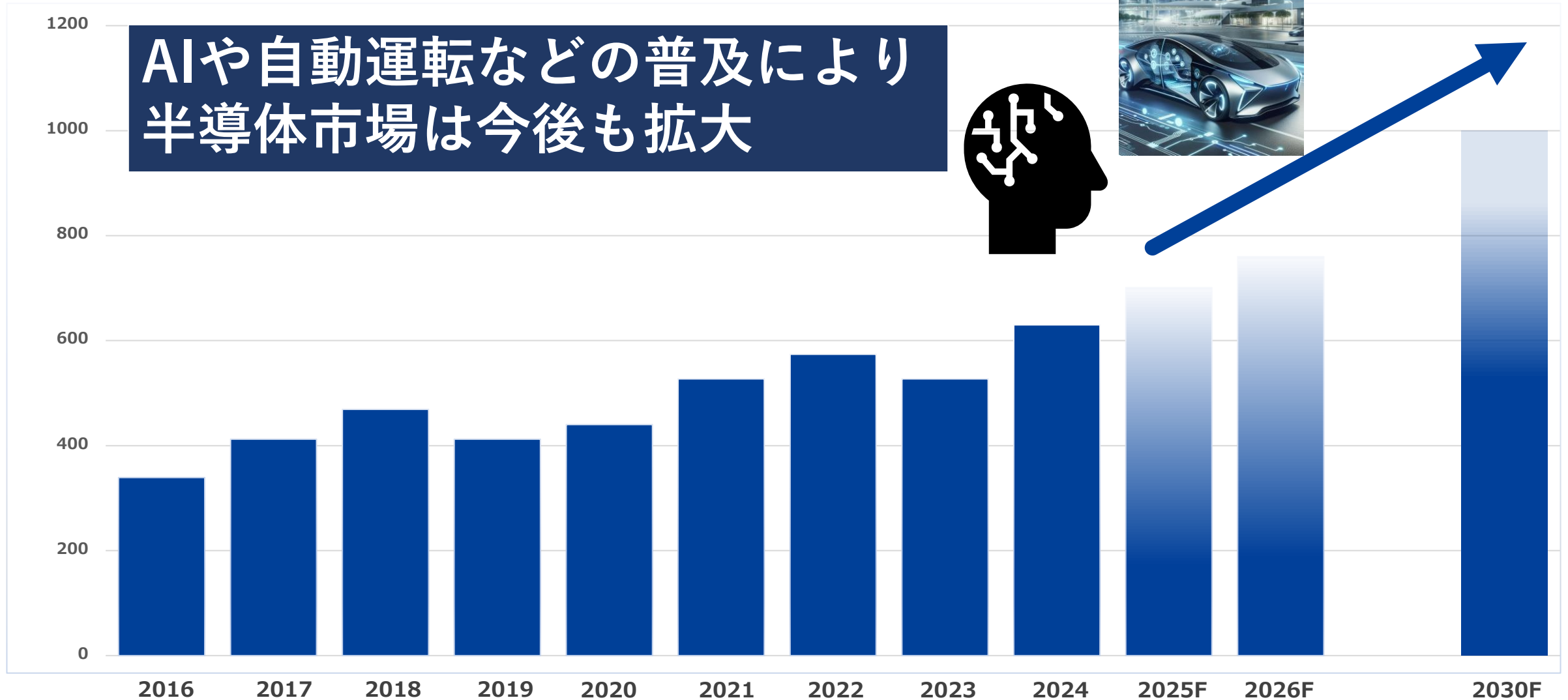
評価相談・金型検討

製品開発

TOWAは、お客様の開発スピードに合わせ
世界各地のラボからスピーディかつ実践的な技術サポートを提供。
製品化・量産化まで一貫した体制で、お客様の製品立ち上げを支援します。

半導体市場予測

【US\$ Billion】



(出典:WSTSおよびSEMIジャパン)

第二次中期経営計画

第一次中期経営計画

「世界の頂」への基盤強化

第二次中期経営計画

新たな課題への挑戦と飛躍

第三次中期経営計画

売上1,000億円と高利益率の達成

TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

2028/3E
売上高
710億円
(1.3倍)
営業利益
156億円
(1.8倍)

2032/3E

売上高
1,000億円
営業利益
250億円

AIにより大きく変化する
半導体業界への対応

2022/3
売上高
506.6億円
営業利益
115.0億円

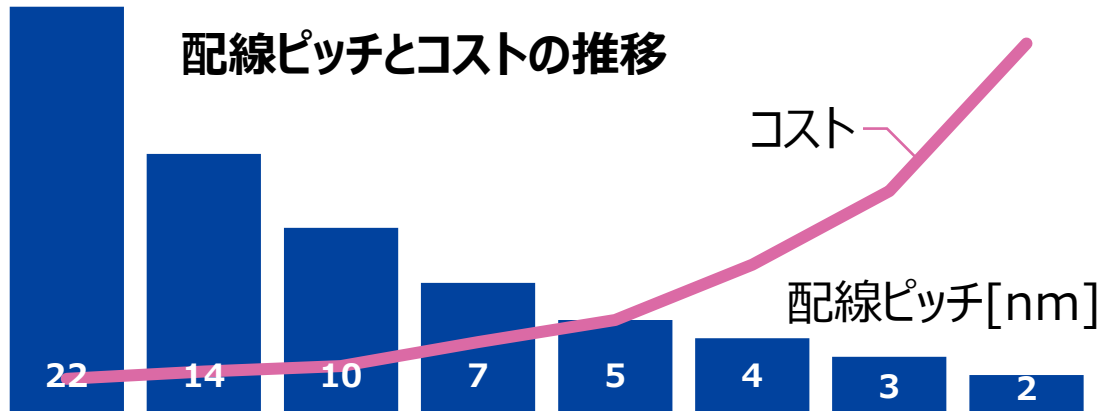
2025/3
売上高
534.7億円
営業利益
88.8億円

先端パッケージにおける前工程と後工程の役割と変化

【前工程】

前工程の微細化は限界に

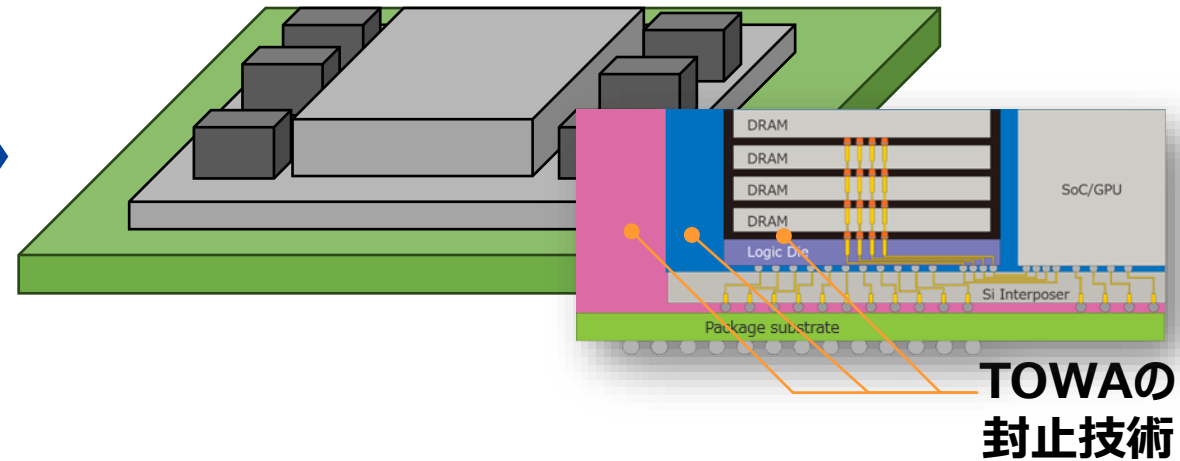
- 3nmや2nmの極限領域へ
- コスト・物理的な壁に直面



【後工程】

封止・実装技術が製品性能を決める

- チップレット／3D実装で効率UP
- 複数チップの統合で新たな性能



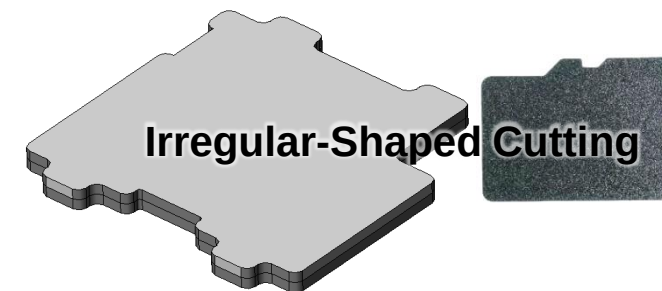
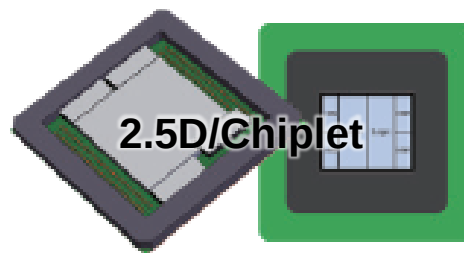
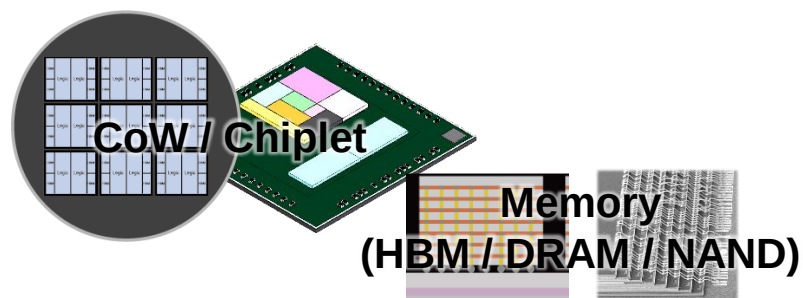
微細化から封止・実装力へ
TOWAは後工程から半導体の進化を支えています

戦略製品について

各ターゲット製品に対し、TOWAはそれぞれに最適な装置をラインナップ。
パッケージ形状・用途に応じた設備選定を可能にしています。

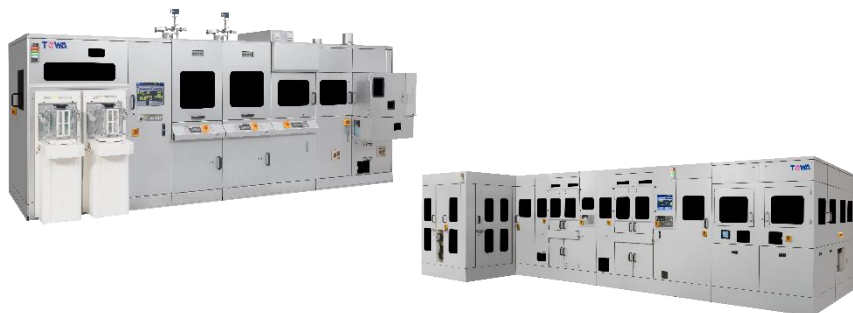
■ モールディングシステム
■ シングレーションシステム

- Target Product -



- System Line-up-

CPM Series



YPM1250-EPQ



LSG1040



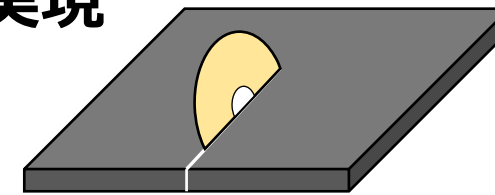
ウェアラブル時代に求められるシンギュレーション技術

従来の半導体は□（四角）が主流。
ウェアラブル製品では身に着けるとい
目的から形状の自由度が求められる。

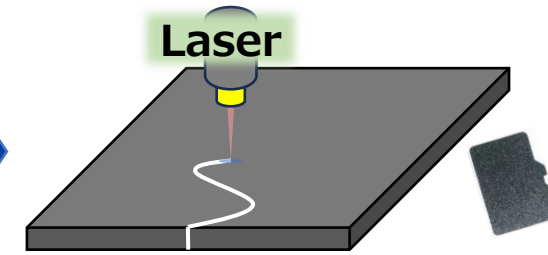


TOWAレーザーシンギュレーション開発

- ✓ 従来を超える**高速・非接触加工**で**高生産性の実現**
- ✓ **複雑・曲線的な形状**にも対応可能



従来
ストレートカットのみ



新技術
ストレート+異形状カット

高速かつ形状自由度を実現する
TOWAの革新的ダイシングソリューション

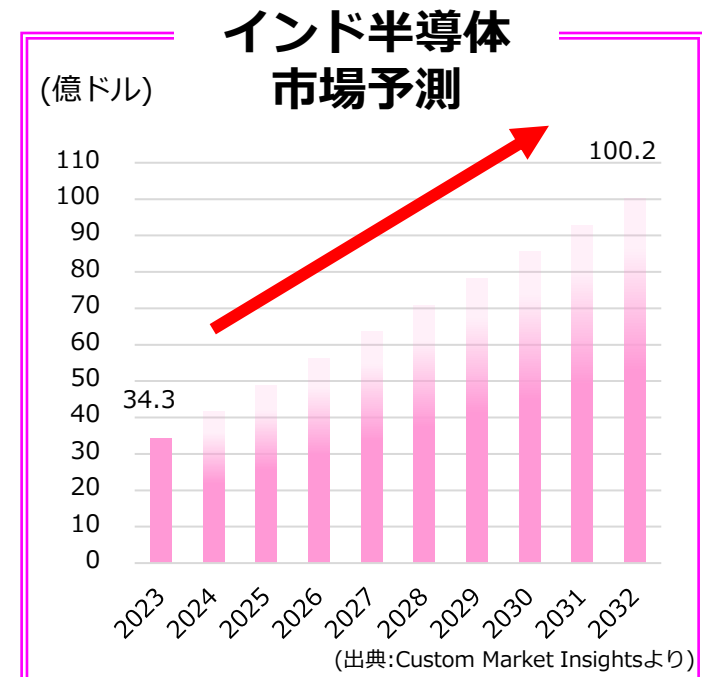
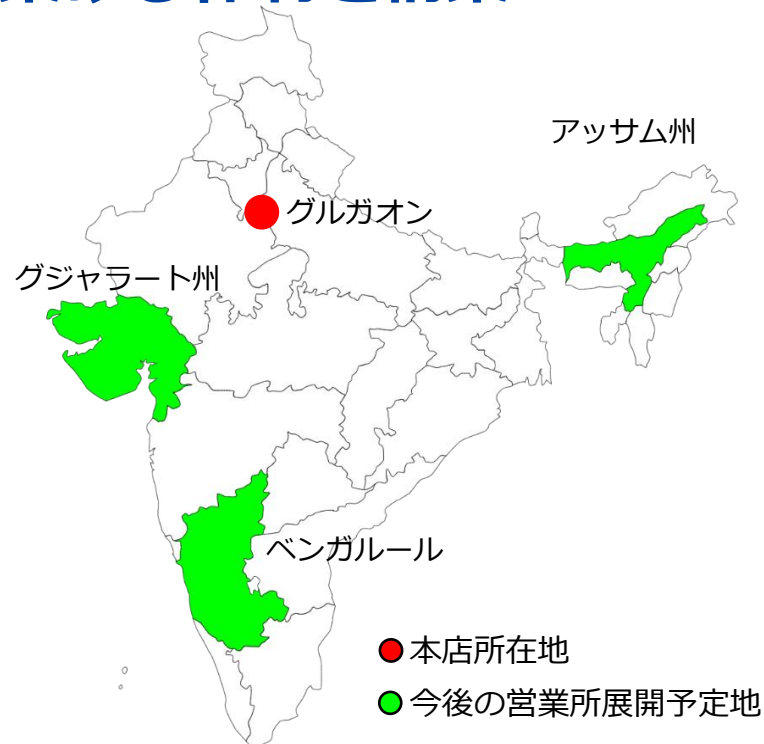
インド市場でのビジネス強化

インドにおける事業強化のため、販売子会社を設立

- ▶ インドでは政府支援のもと半導体産業育成に注力しており、すでに地場の大手財閥や世界の手半導体メーカーによる投資が開始
⇒ 現地で密着した営業およびサービス活動を展開し、立上げ期よりお客様の不安を取り除き、より強固な関係を築ける体制を構築

会社概要

社名	TOWA Semiconductor India Pvt Ltd.
所在地	インド共和国 ハリヤナ州 グルガオン
事業内容	半導体製造装置・金型の販売およびアフターサービス



財務KPI／株主還元

- ・ 資本効率改善を意識し、新たに「財務KPI」と「株主還元目標」を設定

2028/3期までの目標

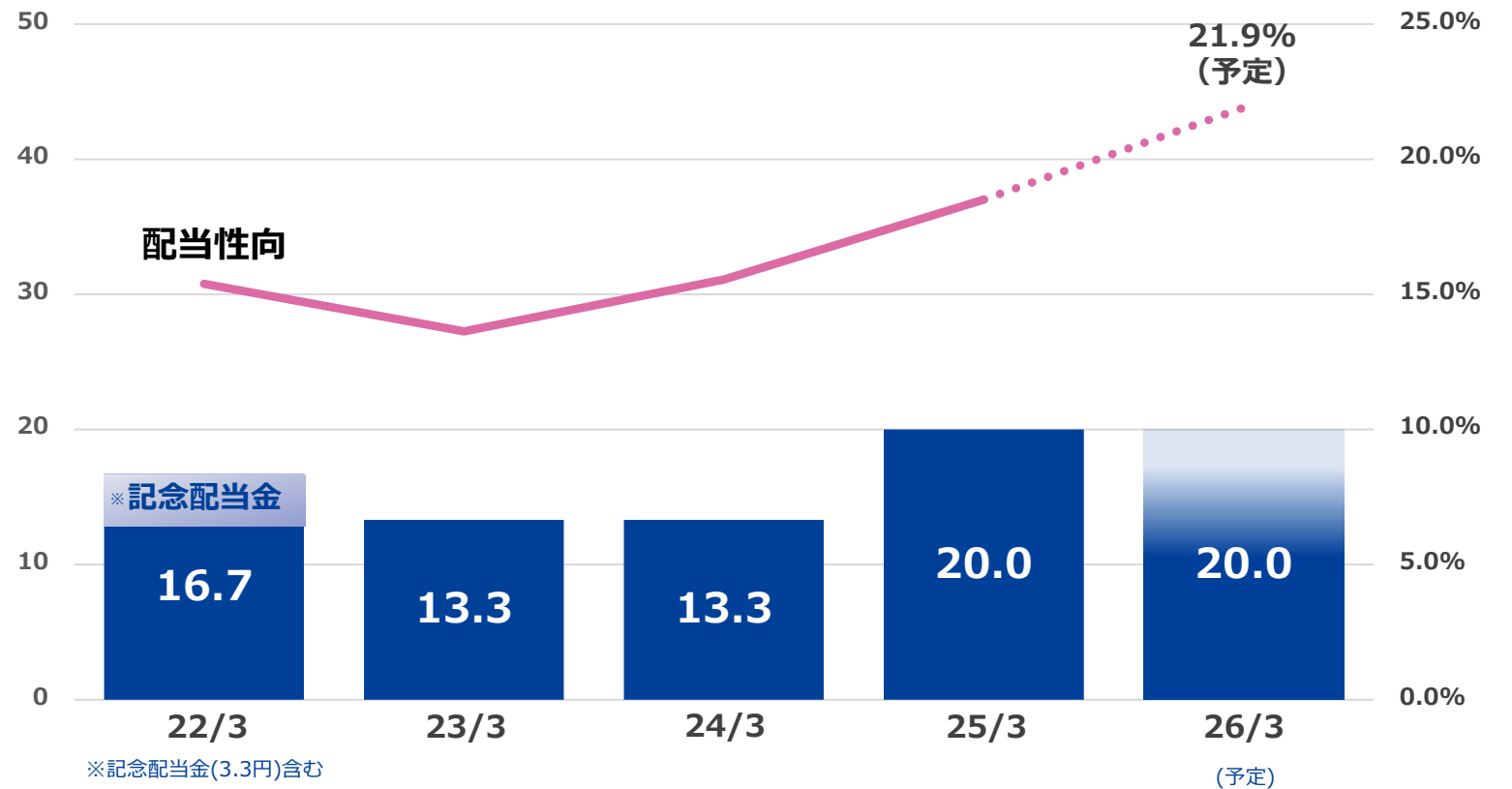
財務KPI

ROE
13%以上

株主還元

配当性向
20%以上

配当金・配当性向の推移



TOWA ビジョン 2032

「変革で世界の頂へ」

